

## 上海华铭智能终端设备股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年05月19日在公司二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，本次会议通知于2017年05月08日以电子邮件、短信和微信等形式送达全体董事。本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中朱依君女士、黄建刚先生以通讯表决方式出席）。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张亮先生主持，与会董事审议了相关议案并做出如下决议：

#### 一、审议通过《关于调整智能终端设备生产线项目投资规划的议案》

根据公司2015年10月22日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目变更的议案》，公司智能终端设备生产线项目（募投项目）投资规划如下：

序号	项目名称	募集资金总投资金额（万元）	占比
1	土建及装修工程	<b>5,655.46</b>	<b>36.55%</b>
	其中：加工车间、组装调试车间建设及装修工程	3,954.46	25.56%
	综合楼建设及装修工程	1,701.00	10.99%
2	生产设备购置及工程预备费	<b>7,647.57</b>	<b>49.43%</b>
	其中：加工车间、组装调试车间设备购置及工程预备费	3,163.65	20.45%
	综合楼设备购置及工程预备费	4,483.92	28.98%
3	铺底流动资金	<b>2,169.37</b>	<b>14.02%</b>
	其中：加工车间、组装调试车间铺底流动资金	1,166.84	7.54%
	综合楼铺底流动资金	1,002.53	6.48%
4	总投资金额	<b>15,472.40</b>	<b>100.00%</b>
	其中：加工车间、组装调试车间总投资	8,284.95	53.55%
	综合楼总投资	7,187.45	46.45%

考虑到业务发展需要，工程建设面积较原计划增加，具体为：公司将原定建设一层但是

层高较高的厂房在保持原有层高不变的情况下改建为两层；综合楼实际建设面积较原计划略有增加；新增连廊、空压机房两处工程建设。另外，自 2016 年下半年以来，包括水泥、钢材、玻璃等在内的建筑材料价格呈现普遍上涨趋势，且预计未来价格仍将保持高位，而且人工价格也在上涨。受上述两方面因素影响，公司智能终端设备生产线项目中土建及装修工程原计划投资金额不足，需要增加投入。为保证公司智能终端设备生产线项目的及时建成完成，公司拟优先确保土建及装修工程的投资建设。因此，公司拟对原募投项目的投资规划进行调整，拟将“生产设备购置及工程预备费”项中的 2,454.74 万元资金调入至“土建及装修工程”项中，“生产设备购置及工程预备费”项目中不足部分公司拟用自有资金补充投入。调整后的募集资金投资规划如下：

序号	项目名称	募集资金总投资金额（万元）	占比
1	<b>土建及装修工程</b>	<b>8,110.20</b>	<b>52.42%</b>
	其中：加工车间、组装调试车间建设及装修工程	5,802.32	37.50%
	综合楼建设及装修工程	2,307.88	14.92%
2	<b>生产设备购置及工程预备费</b>	<b>5,192.83</b>	<b>33.56%</b>
	其中：加工车间、组装调试车间设备购置及工程预备费	3,163.65	20.45%
	综合楼设备购置及工程预备费	2,029.18	13.11%
3	<b>铺底流动资金</b>	<b>2,169.37</b>	<b>14.02%</b>
	其中：加工车间、组装调试车间铺底流动资金	1,166.84	7.54%
	综合楼铺底流动资金	1,002.53	6.48%
4	<b>总投资金额</b>	<b>15,472.40</b>	<b>100.00%</b>
	其中：加工车间、组装调试车间总投资	10,132.81	65.49%
	综合楼总投资	5,339.59	34.51%

公司调整智能终端设备生产线项目投资规划符合公司整体业务规划，有利于加快募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。

光大证券股份有限公司作为公司保荐机构，已经就上述事项出具意见明确表示同意。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于提前使用智能终端设备生产线项目铺底流动资金购买原材料的议案》

公司于 2016 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于提前使用铺底流动资金购买原材料的议案》，同意公司提前使用不超过 1,000 万元的智能终端设备

生产线项目铺底流动资金在相对低的价位购买原材料。

公司在综合考虑募投项目进度、公司在手订单和新生产线预计投入生产的项目数量等情形的基础上，根据公司项目的原材料备货周期，为不影响项目投产后的生产计划，拟将提前使用的智能终端设备生产线项目铺底流动资金额度，再增加 500 万元，即总计提前使用不超过 1,500 万元的智能终端设备生产线项目铺底流动资金，用于购买新厂投产后需要准备的主要原材料。

公司提前使用智能终端设备生产线项目铺底流动资金总计不超过 1,500 万元购买原材料符合公司整体业务规划，有利于加快募投项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。

光大证券股份有限公司作为公司保荐机构，已经就上述事项出具意见明确表示同意。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于变更研发展示中心建设项目实施地点及调整投资规划的议案》

公司研发展示中心建设项目原实施地址位于上海市松江区茸北工业区施惠路北侧，公司拟在松江厂区内通过改造装修一块区域以建设研发展示中心，建筑面积为 1,300 平方米，其中研发测试车间占地面积为 900 平方米，研发办公区占地面积 200 平方米，展示中心占地面积 200 平方米。研发展示中心建设项目原投资规划如下：

研发展示中心募投资金概算			
序号	项目	金额（万元）	占比
1	固定资产投资	1,230.00	68.72%
1.1	改造及装修	355.00	19.83%
1.2	设备及软件购置	815.00	45.53%
1.3	预备费	60.00	3.35%
2	研发人员支出	370.00	20.67%
3	铺底流动资金	190.00	10.61%
总投资		<b>1,790.00</b>	<b>100.00%</b>

由于公司规划及业务发展需要，公司拟将研发展示中心建设项目实施地点变更至平湖市临沪产业园（新埭镇）内，即公司智能终端设备生产线项目实施地点。公司拟通过与智能终端设备生产线项目共同施工建造综合楼，并对部分综合楼区域进行装修的方式实施该项目，公司和全资子公司智达信自动化设备有限公司将分摊综合楼的建设投入，并分别和施工单位签署工程承包协议。

基于上述调整，公司拟调整研发展示中心建设项目建设面积及投资规划。调整后的研发展示中心建设项目建设面积合计 2,235.00 平方米，其中研发测试车间和展示中心合计占地面积为 1,317.05 平方米，研发办公区占地面积为 917.95 平方米。

同时，为保证研发展示中心建设项目的及时建成完成，公司拟优先确保土建及装修工程的投资建设。因此，公司拟对原项目的投资规划进行调整，拟将“设备及软件购置”项中的 515 万元资金调入至“土建及装修”项中，“设备及软件购置”项目中不足部分公司将通过自筹资金或其他方式解决。调整后的投资规划如下：

研发展示中心募投资金概算			
序号	项目	金额（万元）	占比
1	固定资产投资	1,230.00	68.72%
1.1	土建及装修	870.00	48.60%
1.2	设备及软件购置	300.00	16.76%
1.3	预备费	60.00	3.35%
2	研发人员支出	370.00	20.67%
3	铺底流动资金	190.00	10.61%
总投资		1,790.00	100%

公司本次研发展示建设中心项目实施地点变更及投资规划调整符合公司整体业务规划，有利于加快募投项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。

光大证券股份有限公司作为公司保荐机构，已经就上述事项出具意见明确表示同意。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、备查文件

1、经与会董事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、独立董事关于公司募集资金投资项目相关事项的独立意见；

3、《光大证券股份有限公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司募集资金投资项目相关事项的核查意见》。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 05 月 19 日